# 転写法による強誘電体バラクタと SAW 共振子の集積化と 可変型フィルタへの応用

Integration of ferroelectric varactors on acoustic wave resonators using film transfer technique and their application to tunable RF filters

平野栄樹<sup>1</sup>,木村哲也<sup>2</sup>,掘露伊保龍<sup>2</sup>,江刺正喜<sup>1</sup>,門田道雄<sup>2</sup>,橋本研也<sup>3</sup>, 田中秀治<sup>1</sup> (<sup>1</sup>東北大学,<sup>2</sup>村田製作所,<sup>3</sup>千葉大学)

Hideki Hirano<sup>1</sup>, Tetsuya Kimura<sup>2</sup>, Ivoyl P. Koutsaroff<sup>2</sup>, Masayoshi Esashi<sup>1</sup>, Michio Kadota<sup>2</sup>, Ken-ya Hashimoto<sup>3</sup> and Shuji Tanaka<sup>1</sup> (<sup>1</sup> Tohoku Univ., <sup>2</sup> Murata MFG. Co. Ltd., <sup>3</sup> Chiba Univ.) **E-mail : hirano@mems.mech.tohoku.ac.jp** 

## 1. まえがき

表面弾性波(SAW)共振子や薄膜バルク波共 振子(FBAR)を利用した RF フィルタが携帯無 線端末に多用されている.今後,携帯無線端 末には,周波数資源を有効活用する切り札と なる「コグニティブ無線技術」,仕様変更等に 柔軟に対応できる「リコンフィギュアラブル 無線技術」などの適用が期待されており,周 波数可変型の RF フィルタが求められている. また RF フィルタの温度補償にも周波数可変 機能は有効である。しかし,SAW 共振子や FBAR の共振周波数はそれぞれすだれ電極 (IDT)のピッチや圧電体膜厚でほぼ決まるた め,広い周波数可変幅を持つ弾性波フィルタ は実現できていなかった.

最近,広帯域の弾性波フィルタに可変容量 を付加することでフィルタの帯域幅を調整す る可変方式が提案されている[1].具体的には, 図1に示したラダー型構成において,並列腕 共振子に付加した可変容量 *C*pにより共振周 波数 *f*,を制御し,直列腕共振子に付加した可 変容量 *C*sにより反共振周波数 *fa*を制御するこ とで,フィルタの通過帯域の上限と下限を独 立に制御できる.我々は、ラダー型 SAW フィ ルタに MEMS 可変容量をモノリシックに集 積化した可変 SAW フィルタを作製し,通過帯 域の制御を確認した[2].本研究ではより実用 的な可変 RF フィルタを目指して,小面積で 大きな容量可変幅を持つ強誘電体バラクタと SAW 共振子の集積化を検討した.



### 2. 転写による集積化プロセス

バリウムストロンチウムチタン酸(BST) に代表される強誘電体膜は 700℃前後の成膜 温度が要求される.したがって,LiNbO<sub>3</sub>(LN) 基板との熱膨張率差に起因する膜応力等のた め,LN 基板上に BST 膜を直接形成すること は困難である.この課題を解決するために, 予め Si 基板に成膜した BST 薄膜を,低温で 圧電基板に転写するプロセスを開発した.

図2-aに示すように100nmの熱酸化膜を形成した200µm厚のSi基板に、スパッタ法でPt,BST,Au膜をそれぞれ100nm、200nm、100nm成膜した後にバラクタ構造を形成した.LN基板側は図2-bに示すようにIDTおよび電極を100nm厚のAu膜で形成した.次に両基板をAu 膜同士の金属接合により150℃で接合した.接合後のSi基板はSF6プラズマで完全に除去し、最後にBST層の配線を行った.図3および図4に、それぞれLN基板に転写されたBSTと完成したデバイスの顕微鏡写真を示す.



d. Etching of Si sub. and wiring the IDT and VCs. 図 2 LN 基板への BST 転写プロセス



図 3 LiNbO<sub>3</sub> 基板に転写された BST 膜



図4 完成した可変フィルタ



3. 結果と考察

図5にSi基板上に成膜直後のBST 膜,およびLiNbO3基板への転写後のBST 膜に電圧を印加した際の誘電率を示す.転写したBST 膜も印加電圧に応じて誘電率が変化することが確認できた.ただし,成膜直後のBST 膜と比較すると誘電率および可変率とも低下していた.これは転写プロセス中にBST 層と電極間に形成される低誘電率の変質/劣化層が原因と考えられる.また,転写後のBST 膜に±4V以上の電圧を印加するとバラクタが絶縁破壊した.これはPt層のエッチングプロセス中に膜側壁に再付着したPtでBST 膜が短絡したためだと考えられ,短絡を防止するためのプロセスと構造の再設計を行っている.

BST転写の収率が十分でないためにフィル タ特性の評価までには至っていないが,今後, 抽出された課題を解決し,ラダー型 SAW 共 振子フィルタの通過帯域可変性を検証する予 定である.

#### 4. あとがき

SAW 共振子と強誘電体バラクタのヘテロ 集積化による可変 RF フィルタの実現を目的 として, LN 基板への BST 素子の低温転写を 実証し,バラクタ特性を確認した.本研究で 開発した異種要素の転写プロセスは,LSI と 弾性波共振子など,一般に集積化が困難と考 えられてきた異種要素の集積化に幅広く展開 できると期待される.

#### 謝辞

本研究は、日本学術振興会の「最先端開発 支援プログラム」の支援を受けて行われた.

#### 参考文献

- T. Komatsu, K Hashimoto, T. Omori and M. Yamaguchi, "Tunable radio-frequency filters using acoustic wave resonators and variable capacitors", Jpn. J. Appl. Phys., 49, 07HD24, 2010.
- [2] T. Yasue, T. Komatsu, N. Nakamura, K. Hashimoto, H. Hirano, M. Esashi and S. Tanaka, "Wideband tunable Love wave filter using electrostatically -actuated MEMS variable capacitors integrated on Lithium Niobate", Tech. Digest, Transduser'11, Beijing, China, June 5-9, 2011, pp. 1488-1491.